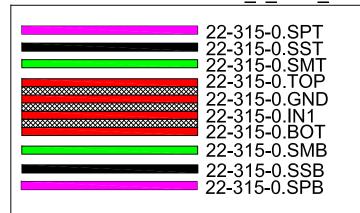


DRILL CHART								
SYM	DIAM	TOL	QTY	NOTE				
⊞	0.200 mm		182					
+	1.000 mm		20					
♦	1.100 mm		9					
Ф	3.500 mm		1					
×	3.500 mm		3	NON-PLATED				
TOTAL			215					

PCB STACK-UP 4 LAYERS_2_SMD_UP



MATERIALE

TIPOLOGIA CIRCUITO	SUPPORTO	SPESSORE RAME	
☐ MONOFACCIA	☐ FR2	X LATI ESTERNI 35u	
DOPPIA FACCIA	X FR4	LATI INTERNI	
▼ MULTISTRATO	□ALTRO	SPESSORE SUPPORTO	
N°LAYERS 4		1.6 mm	

TRATTAMENTI

RAME DI RIPORTO ELETTROLITICO MIN. 20u					
☐PLACC.ELETT. SURFUSOS	Sn/Pb 60/40-70/30 Sp.10-20u				
□PLACC.ELETT. RIFUSO S	Sn/Pb 60/40-70/30 Sp. 4-15u				
RAME PASSIVATO	MHOT AIR LEVELING				
□DORATURA(D=140±vPN)	0.3u0.6u1,0u1,3u2,0u				
□BISELLATURA	NUMERO DEI CONTATTI				
DEPOSITO DI GRAFITE	NUMERO DEI CONTATTI				

SOLDER RESIST	SERIGRAFIA
SERIGRAFICO Sp.	XLATO COMP.COLORE BIANCO
XFOTOGRAFICO Sp. 13−100u	XLATO SALD. COLORE BIANCO
COVER LAYERSp. 25-76u	

TABELLA DEI FORI CON				FILES DI DOCUMENTAZIONE	
LAVORAZ. PARTICOLARI			DLARI	ASSOCIATI PER LA LAVORAZIONE	
TIPO	ø MET.	ø N.MET.	Q.TA'	LAYER BOT	∑ 22-315-0.BOT
Α				LAYER TOP	X 22-315-0.TOP
В				LAYER PWR	
С				LAYER GND	💢 22-315-0.GND
D				SERIG. BOT	💢 22-315-0.SSB
Е				SERIG. TOP	💢 22-315-0.SST
F				LAYER IN1	💢 22-315-0.IN1
G				LAYER IN2	
Н				LAYER IN3	
I				LAYER IN4	
L				RESIST BOT	💢 22-315-0.SMB
М				RESIST TOP	💢 22-315-0.SMT
NOTE PARTICOLARI			ARI	PAST BOT	💢 22-315-0.SPB
				PAST TOP	X 22-315-0.SPT
				LAYER FOR.	X 22-315-0.DRL
				DRILL CHART	
				DRILL TAPE	X 22-315-0.TAP
TUTTI I FORI NON INDICATI DEVONO			.	MECC.DRW.	💢 22-315-0.DWG
ESSERE METALLIZATI					

